2027年3月期 第2四半期決算説明

芝浦メカトロニクス株式会社

2026年11月5日

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Contents

01 2027年3月期 第2四半期 連結業績

02 2027年3月期 連結業績予想

03 中期経営計画の進捗

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

01 2027年3月期 第2四半期 連結業績

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

業績サマリー

■ 売上高・利益

- 前年比 増収減益

  売上高 432億円（2%増）、営業利益 61億円（19%減）

  半導体後工程は生成AI需要を背景に好調に推移し増収増益。

  半導体前工程は売上の減少、成長投資の減価償却費の増加により減収減益、全体では増収減益。

■ 業績予想

- 通期業績予想、年間配当予想を上方修正

  売上高 1,050億円、営業利益 175億円、ROS 16.7%、配当 67円

■ 受注高

- 前年比 大幅に増加

  受注高　791億円、前年比 92%増加、前下期比 70%増加

  半導体後工程は生成AI需要を背景に、先端パッケージ向け装置が好調に推移し大幅に増加。

  半導体前工程はSiウェーハ向け装置、マスク向け装置がともに堅調に推移。

■ 受注残高

- 2026年9月末 842億円

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

業績結果（対前年）

（億円）	2025年度		2026年度	
	上期	下期	**上期**	対前年増減率
売上高	423	457	**432**	+2%
営業利益	76	77	**61**	-19%
ROS	17.9%	16.8%	**14.2%**	-3.7pt
経常利益	74	75	**62**	-16%
当期純利益	53	59	**43**	-20%
受注高	412	465	**791**	+92%
FCF	-42	7	**294**	+336億円

■ 売上高

前年比2%増収　(423億円 ⇒ 432億円)

- 半導体後工程は生成AI関連需要を背景に増加、半導体前工程は一部売上の下期以降へのシフトにより減少、全体では増収。

■ 営業利益

前年比19%減益　(76億円 ⇒ 61億円)

- 半導体前工程の売上減少及び成長投資による減価償却の増加などにより減益。

■ 受注高

前年比92%増加（412億円　⇒ 791億円）

- 半導体後工程は生成AI需要を背景に大幅に増加。半導体前工程はSiウェーハ向け装置、マスク向け装置がともに堅調に推移。

■ FCF

前年比336億円増加（-42億円　⇒ 294億円）

- 受注増に伴う前受金の増加により上期のFCFは大幅改善。

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

セグメント別業績結果（対前年）①

■ ファインメカトロニクス部門

＊ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程

- **売上高**　　前年比 3%減　(226億円 ⇒ 220億円)

  半導体前工程は顧客の投資計画見直しや、一部案件の納入時期変更に伴う進行スケジュールの調整を行った結果、当初計画から売上の一部が下期以降へシフトし減少。時期要因による一時的なもので、全体としてはおおむね計画どおり進捗。

  FPD前工程は低調で減少。

- **セグメント利益**　　前年比 55%減　(32億円 ⇒ 14億円)

  売上減少及び成長投資に伴う減価償却費の増加により減益。

- **受注高**　　前年比 35%増　(235億円 ⇒ 317億円)

  半導体前工程はSiウェーハ向け装置、マスク向け装置がともに堅調に推移。

  FPD前工程は市況の影響により減少。

*海外関係会社の業績は従来ﾌｧｲﾝﾒｶﾄﾛﾆｸｽｾｸﾞﾒﾝﾄに一括計上していましたが、26年度より各ｾｸﾞﾒﾝﾄ由来に区分し計上する方法に変更しています。
なお、当資料は23年度まで遡り、変更後の区分方法により作成しています。

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

セグメント別業績結果（対前年）②

■ メカトロニクスシステム部門

*ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｼｽﾃﾑ部門：半導体/FPD後工程、真空応用

- **売上高**　前年比 12%増　(173億円 ⇒ 194億円)

  半導体後工程は生成AI需要を背景に先端パッケージ向け装置が増加。
  FPD後工程及び真空応用装置は減少。

- **セグメント利益**　前年比 15%増　(47億円 ⇒ 54億円)

  半導体後工程の売上増加により増益。

- **受注高**　前年比 195%増　(154億円 ⇒ 456億円)

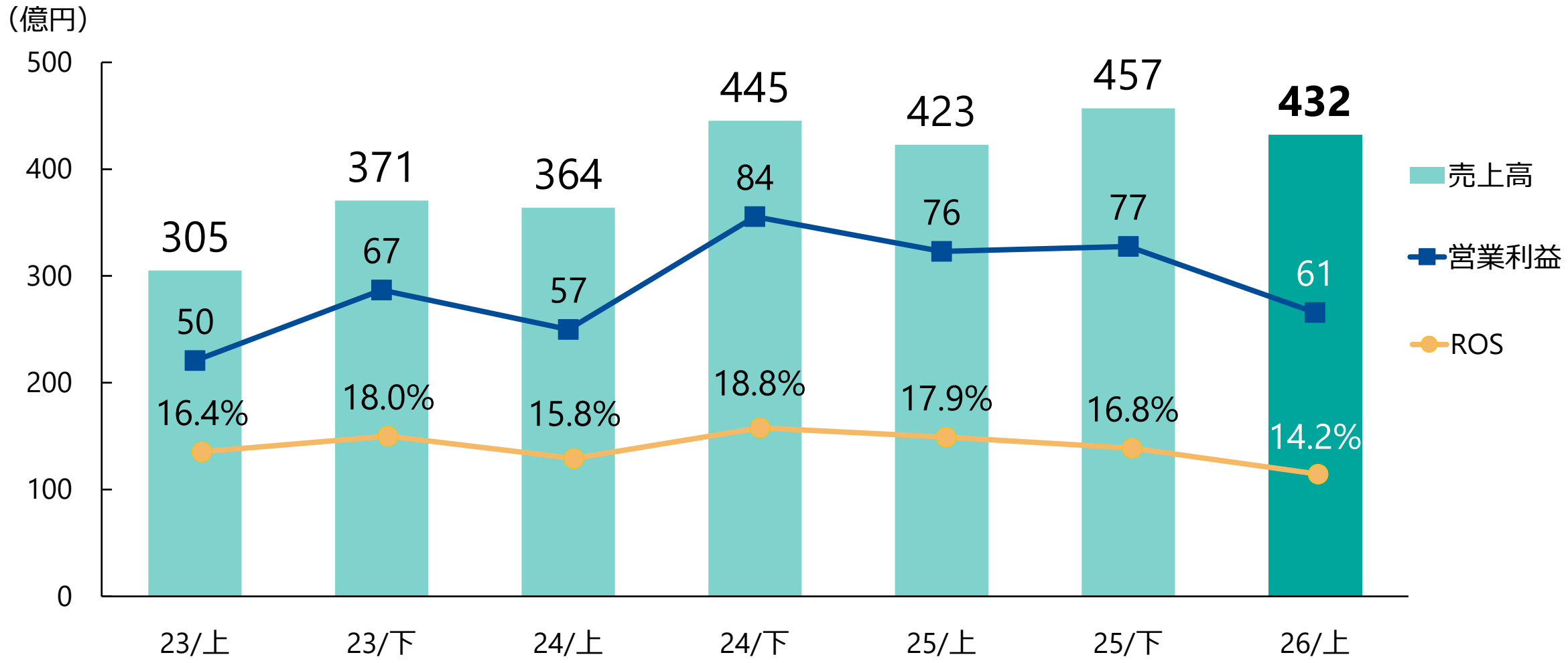
  半導体後工程は生成AI需要を背景に、先端パッケージ向け装置が大幅に増加。
  FPD後工程は市況の影響により低調に推移、真空応用装置は増加。

*海外関係会社の業績は従来ﾌｧｲﾝﾒｶﾄﾛﾆｸｽｾｸﾞﾒﾝﾄに一括計上していましたが、26年度より各ｾｸﾞﾒﾝﾄ由来に区分し計上する方法に変更しています。
なお、当資料は23年度まで遡り、変更後の区分方法により作成しています。

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

売上高・利益・ROS

» 減収や成長投資に伴う減価償却費の増加などにより、上期では減益、一時的にROS低下。

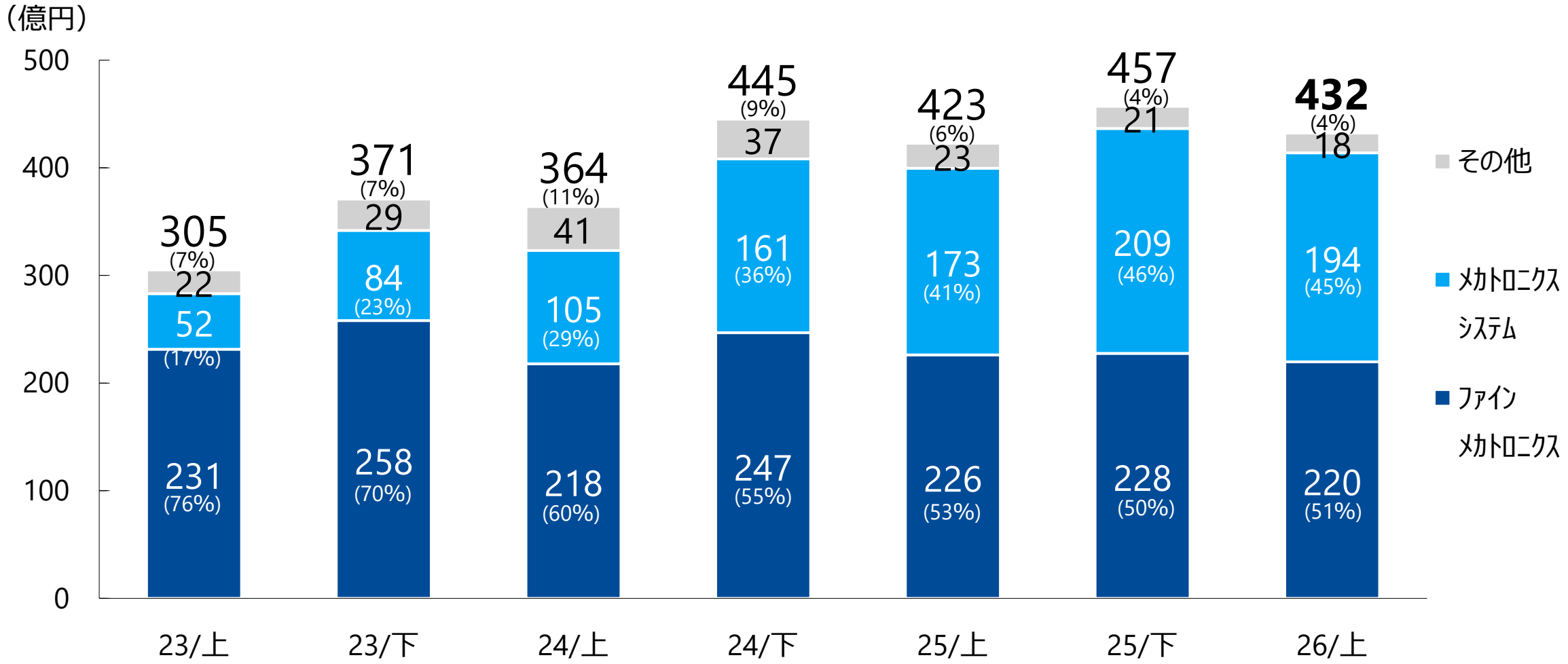


COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

セグメント別売上高

» ファインメカトロニクス 51%
» メカトロニクスシステム 45%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程、真空応用



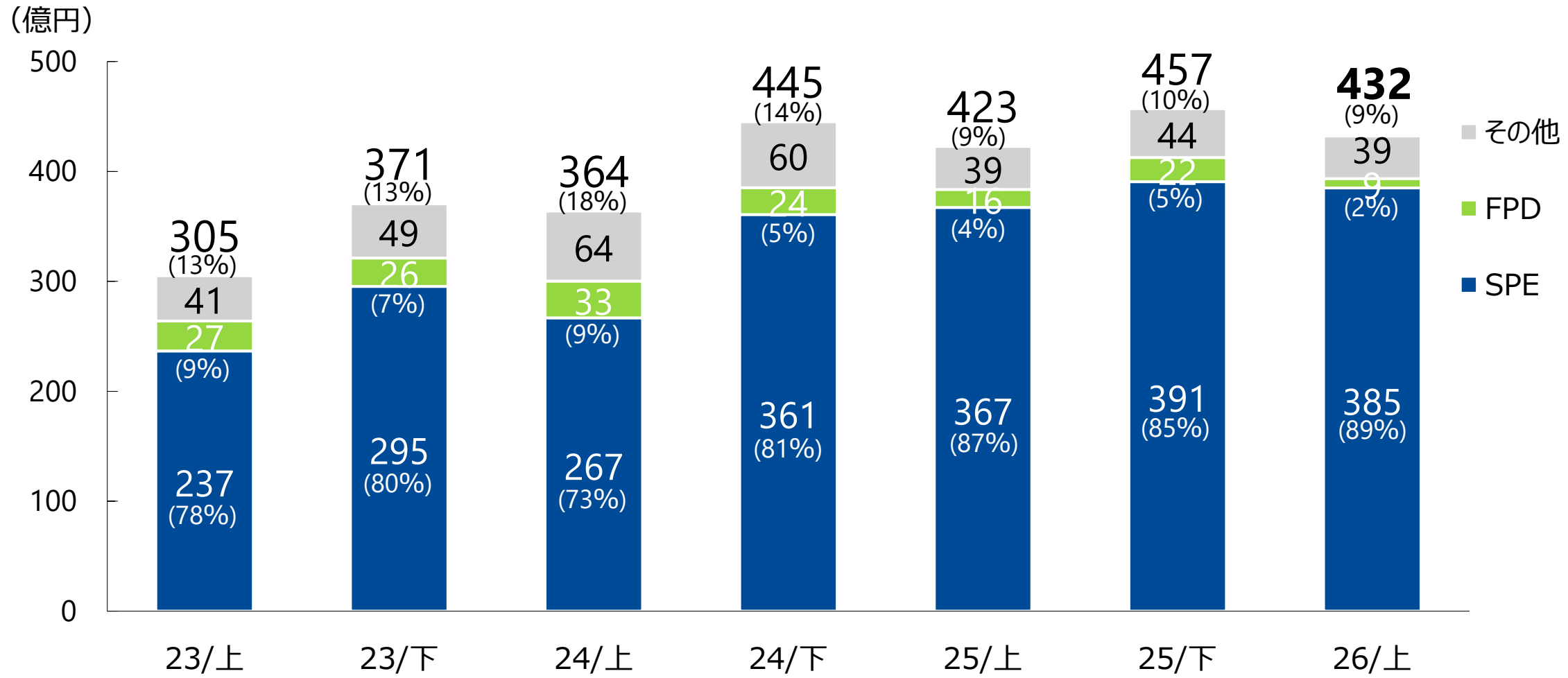
*海外関係会社の業績は従来ファインメカトロニクスセグメントに一括計上していましたが、26年度より各セグメント由来に区分し計上する方法に変更しています。
なお、当資料は23年度まで遡り、変更後の区分方法により作成しています。

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

分野別売上高

» SPE分野89%まで上昇

* SPE：半導体前･後工程
FPD：FPD前･後工程

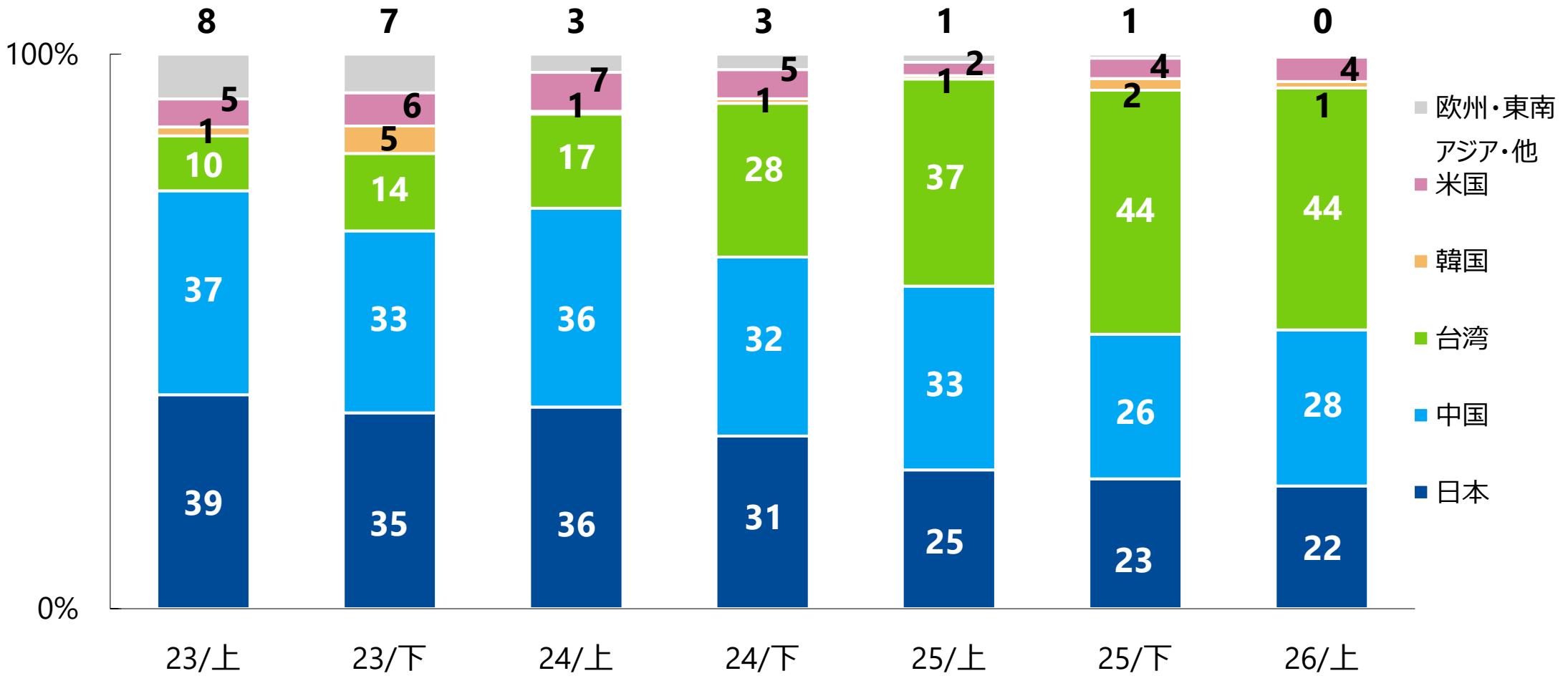


COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

地域別売上高比率

» 海外向け78%（台湾44%、中国28%）

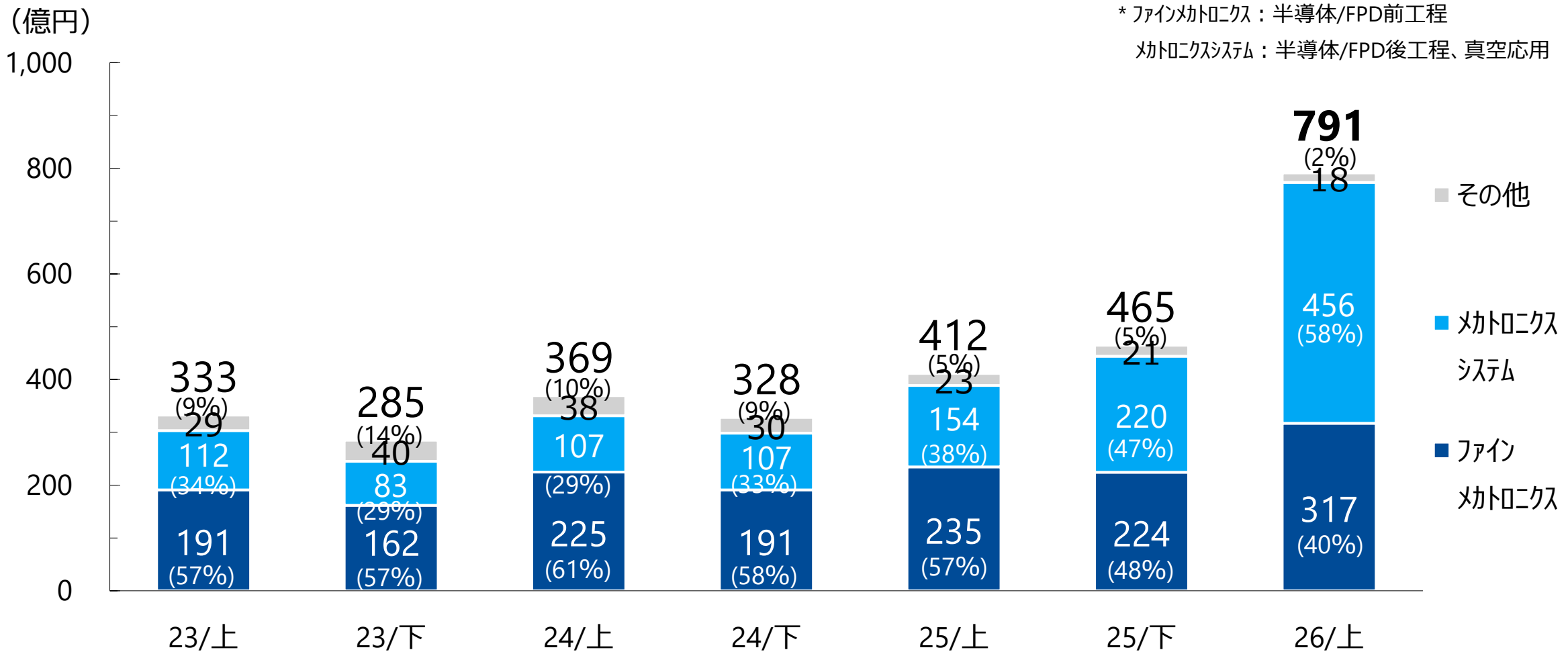
＊ 仕向地で区分



COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

セグメント別受注高

» 半導体後工程の先端パッケージ向け装置が大幅増：25/上比 92%増加、25/下比 70%増加
ファインメカトロニクス 40%、メカトロニクスシステム 58%

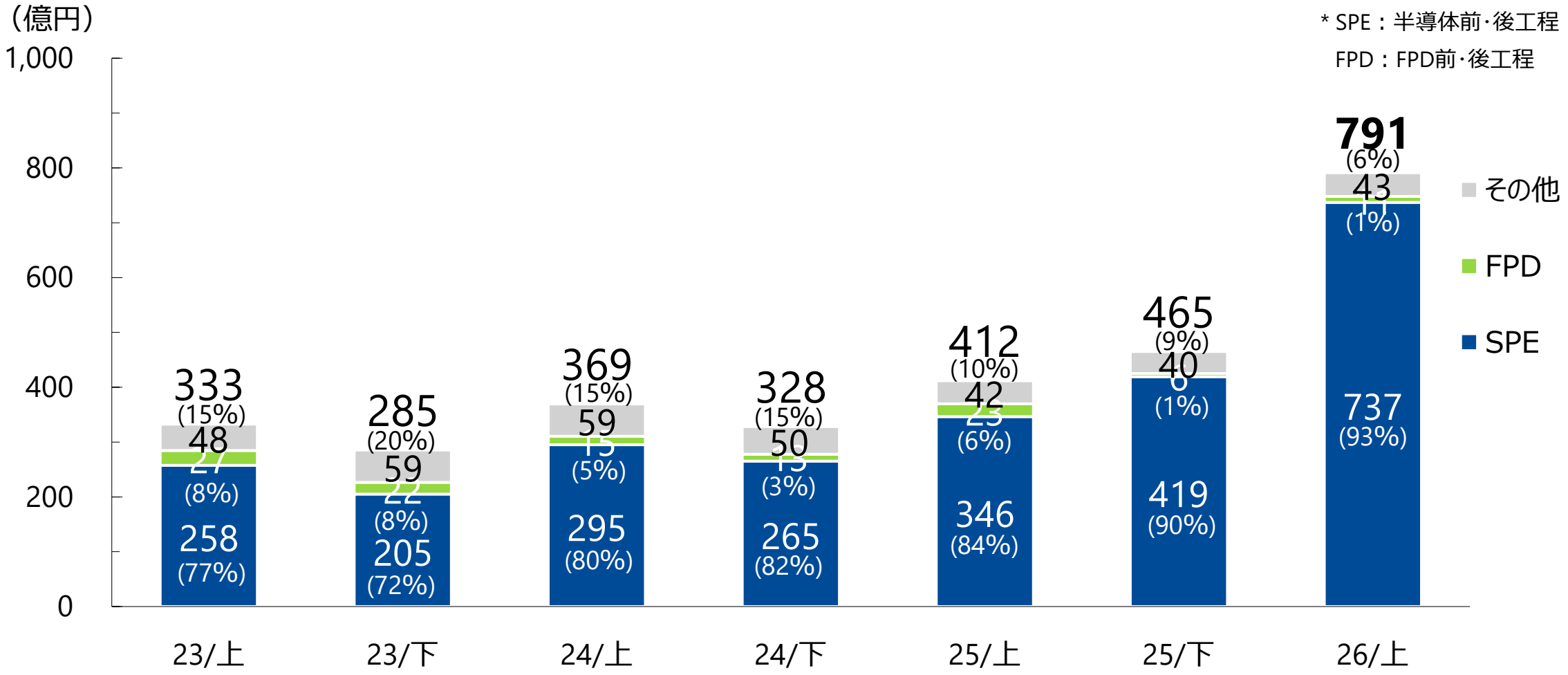


*海外関係会社の業績は従来ファインメカトロニクスセグメントに一括計上していましたが、26年度より各セグメント由来に区分し計上する方法に変更しています。
なお、当資料は23年度まで遡り、変更後の区分方法により作成しています。

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

分野別受注高

» 半導体後工程の先端パッケージ向け装置の受注拡大、半導体前工程はSiウェーハ向け装置、マスク向け装置の増加により、SPE分野は規模拡大とともに構成比も93%に上昇

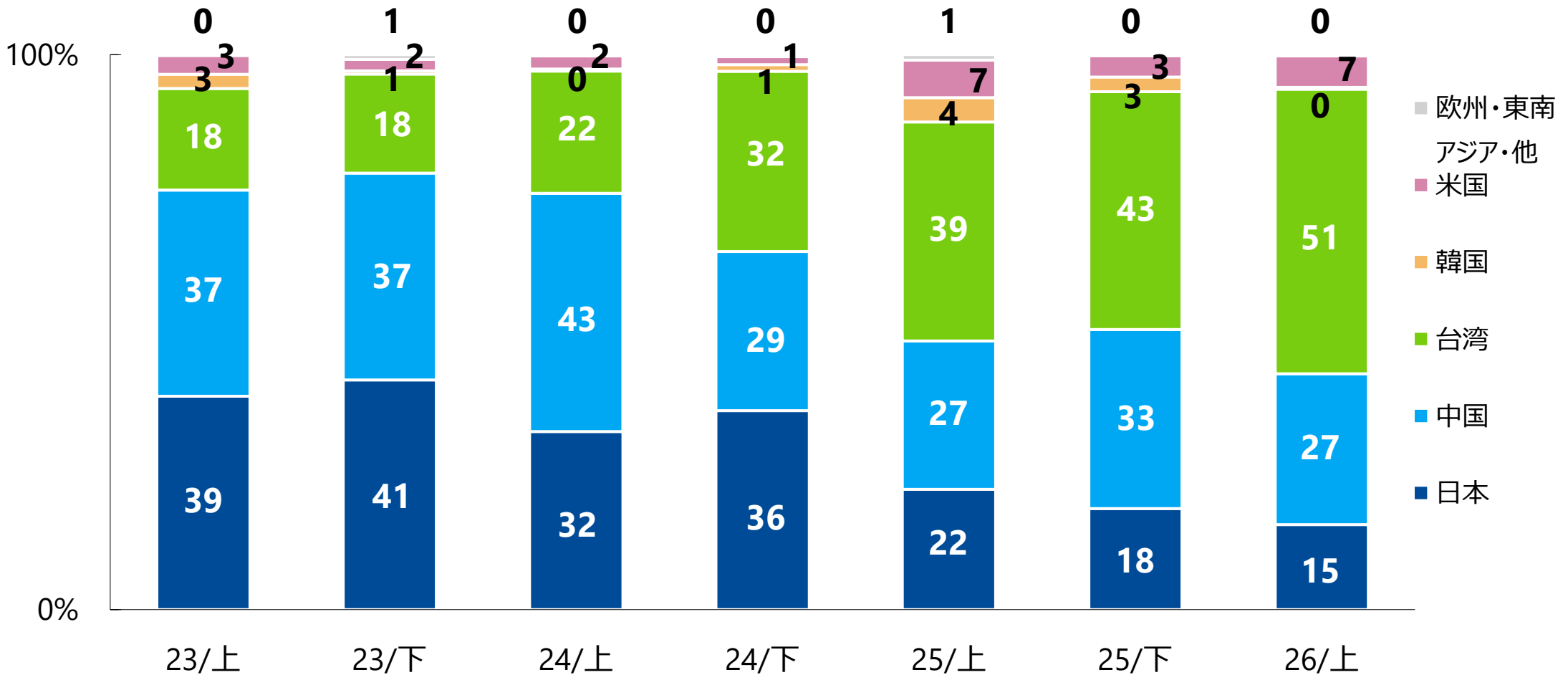


COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

地域別受注高比率

» 海外向け85%（台湾51%、中国27%）

＊ 仕向地で区分

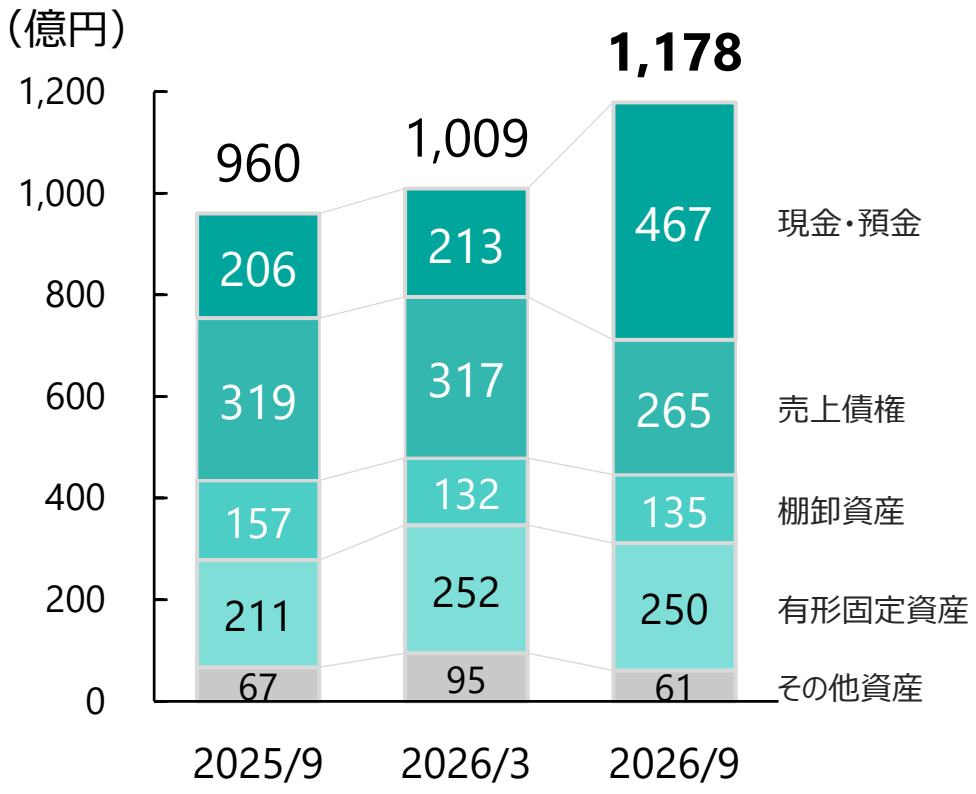


COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

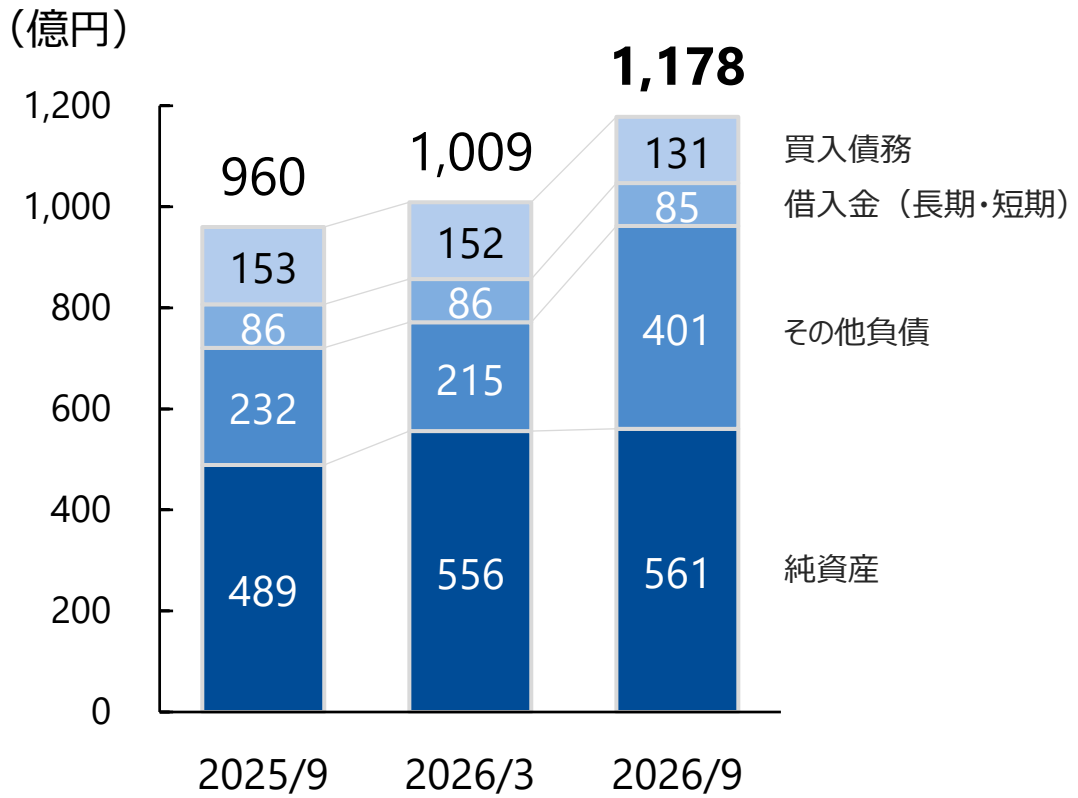
貸借対照表

» 自己資本比率　55% ('26/3) →　48% ('26/9)
D/Eレシオ　0.16倍 ('26/3) → 0.15倍 ('26/9)

資産



負債及び純資産



COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

02 2027年3月期 連結業績予想

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

業績予想サマリー

■ 当社の事業環境

- 半導体業界は、AI需要の高まりに牽引され、AIに関連するロジック/ファウンドリ向け、メモリ向けなどの設備投資が引き続き堅調に推移、先端パッケージ向け設備投資も旺盛。パワーデバイス向けは未だ低調と見込む。
- 半導体輸出規制強化、部品の長納期化等のリスクを継続注視しながら、半導体市場全体の中長期的な拡大に期待。

■ 通期業績予想

- 2026年度業績は、業績進捗等を踏まえ前回予想から上方修正

売上高	990億円	⇒	1,050億円（前回予想比+6%）
営業利益	160億円	⇒	175億円（前回予想比+9%）
ROS	16.2%	⇒	16.7%（前回予想比+0.5pt）
配当	64円	⇒	67円（前回予想比+3円）

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

業績予想

» 2026年度は前回予想から売上高、利益とも上回る見込み

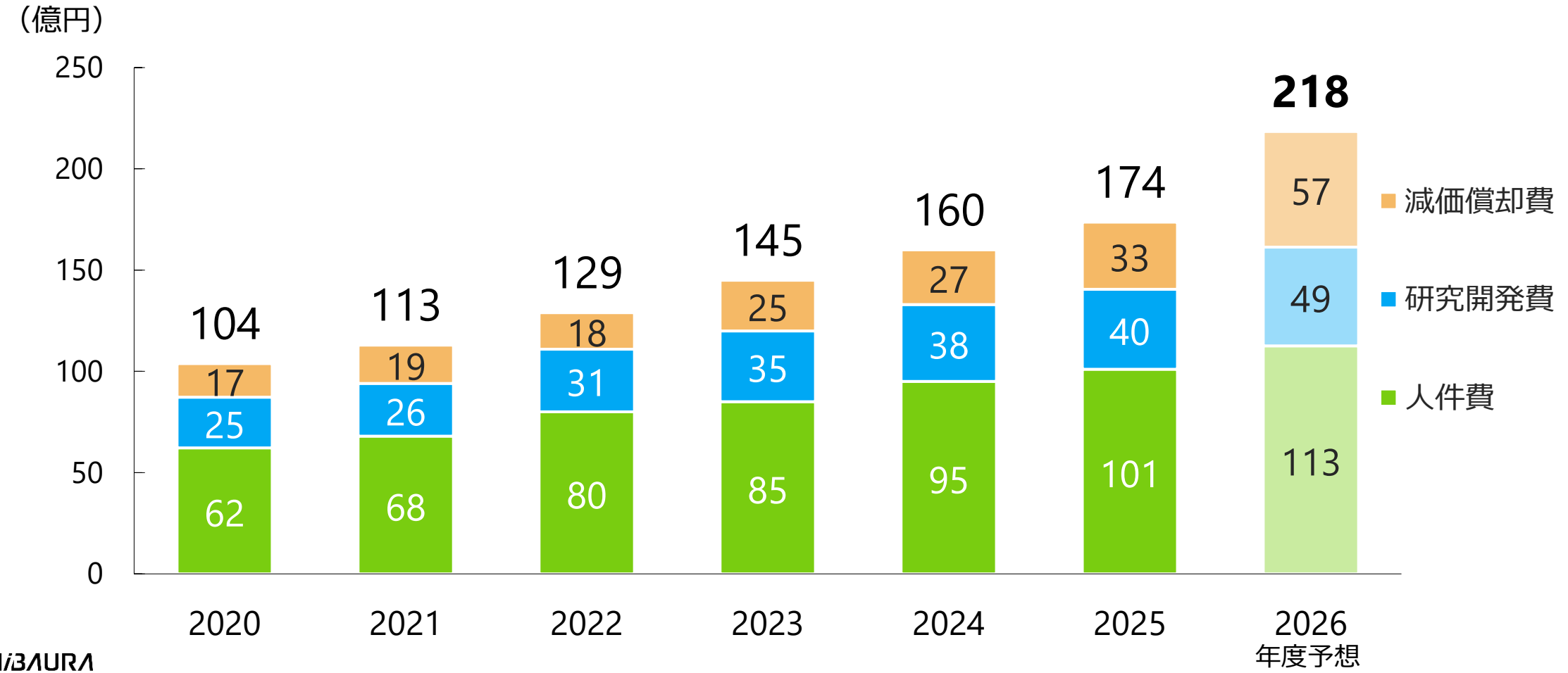
*1: 2026年5月公表

（億円）	2023年度	2024年度	2025年度			2026年度			前回予想*1 2026年度	前回予想比増減率
			上期	下期	年度	上期	下期	年度		
売上高	676	809	423	457	880	432	618	**1,050**	990	+6%
営業利益	117	141	76	77	153	61	114	**175**	160	+9%
ROS	17.3%	17.5%	17.9%	16.8%	17.3%	14.2%	18.4%	**16.7%**	16.2%	+0.5pt
経常利益	116	140	74	75	149	62	112	**174**	157	+11%
当期純利益	88	103	53	59	112	43	82	**125**	119	+5%
ROE	24.5%	24.0%	—	—	21.7%	—	—	**21.2%**	20.0%	+1.2pt
FCF	37	38	-42	7	-35	294	-109	**185**	5	+180億円

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

成長投資費用予想（計画）

- 開発評価機や新棟の減価償却費など、成長投資費用は前回（2026年5月）公表の213億円から５億円増加し、218億円の見込み
- 顧客の拡大や外部連携、新GNT製品の創出など、投資成果の刈取り、成長加速・拡大に繋げる



COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

配当予想

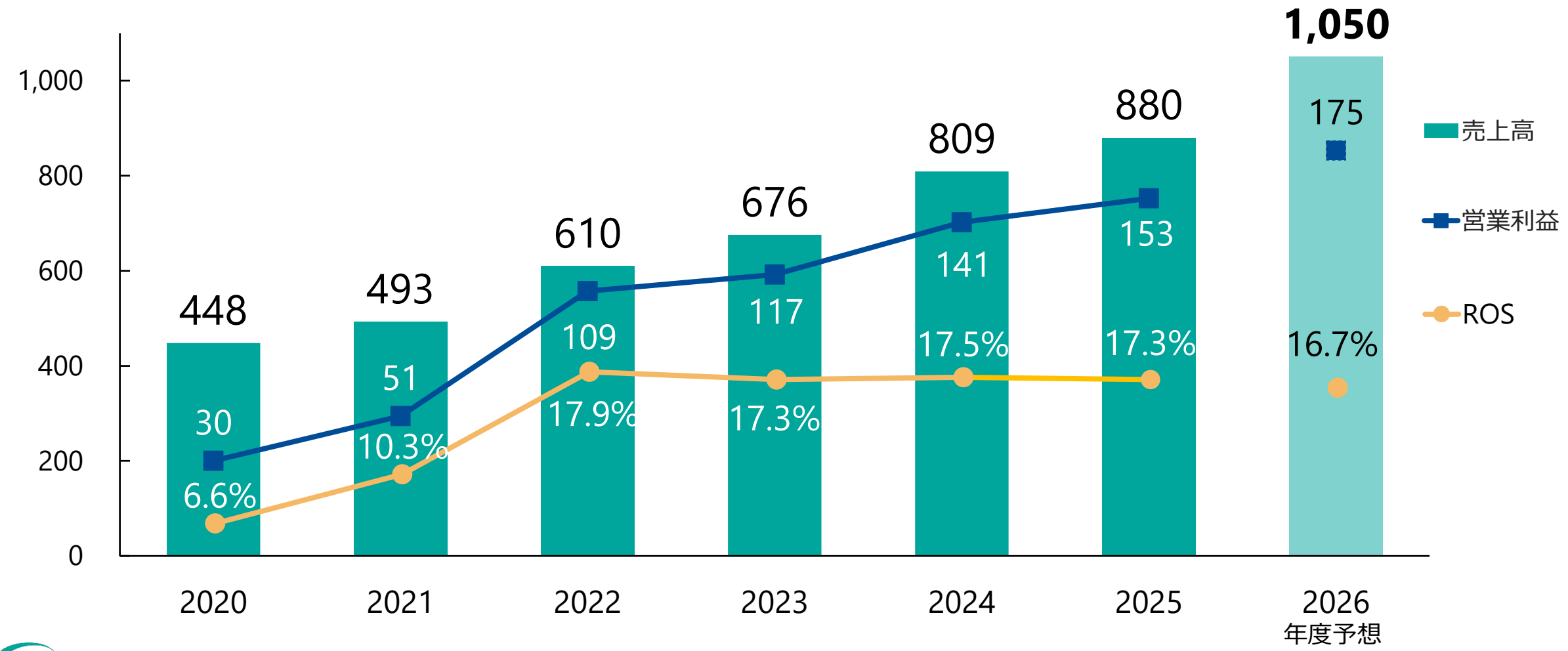
当社は、連結配当性向をおおむね35%を目途としています。
2026年度 業績予想の上方修正に伴い、期末配当は前回予想から
3円増配の67円に修正しています。（連結配当性向35.2%）

	第2四半期末配当	期末配当	年間配当
2027年3月期	0円	67円	67円
2027年3月期 （前回26年5月予想）	0円	64円	64円

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

売上高・利益・ROS予想

- 売上・利益規模の拡大を見込む
- ROSは成長投資の増加により17%前後で推移、更なる上昇を目指す

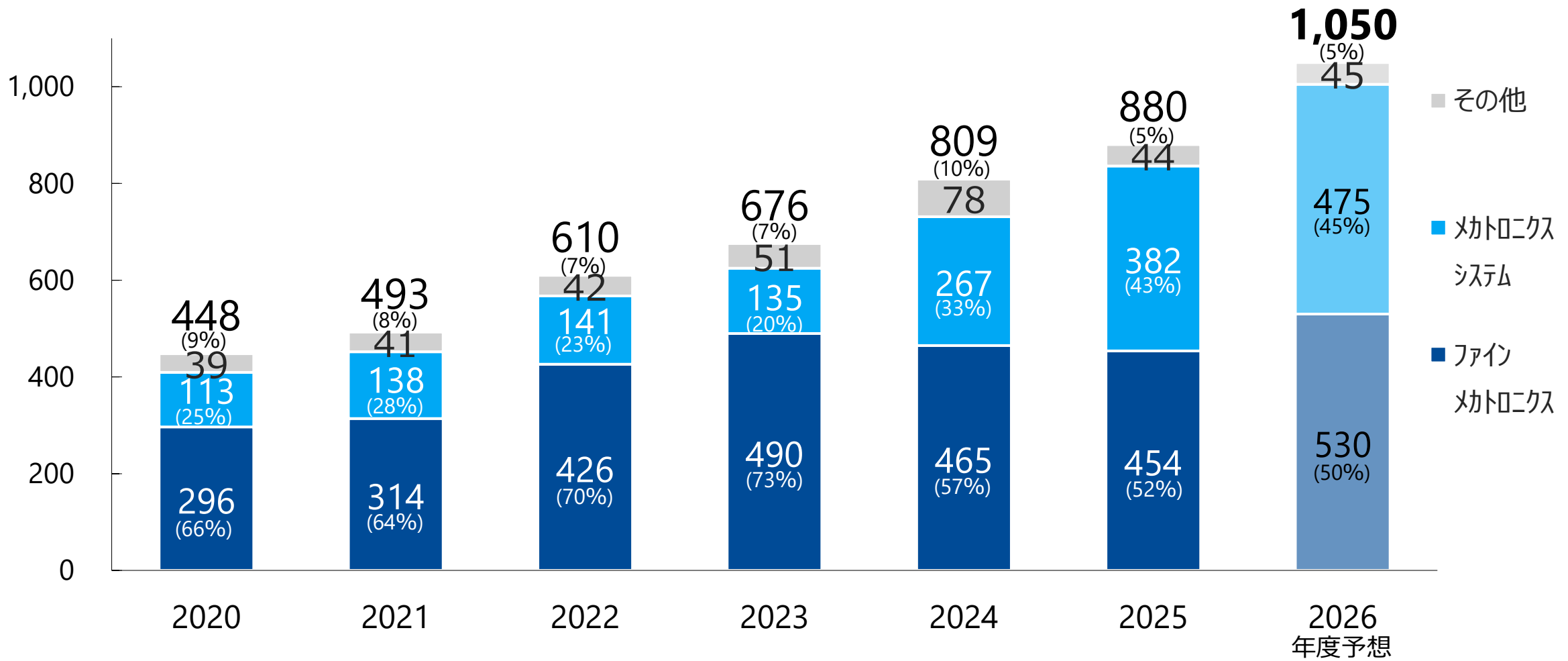


COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

セグメント別売上高予想

» ファインメカトロニクス 50%
» メカトロニクスシステム 45%

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程、真空応用



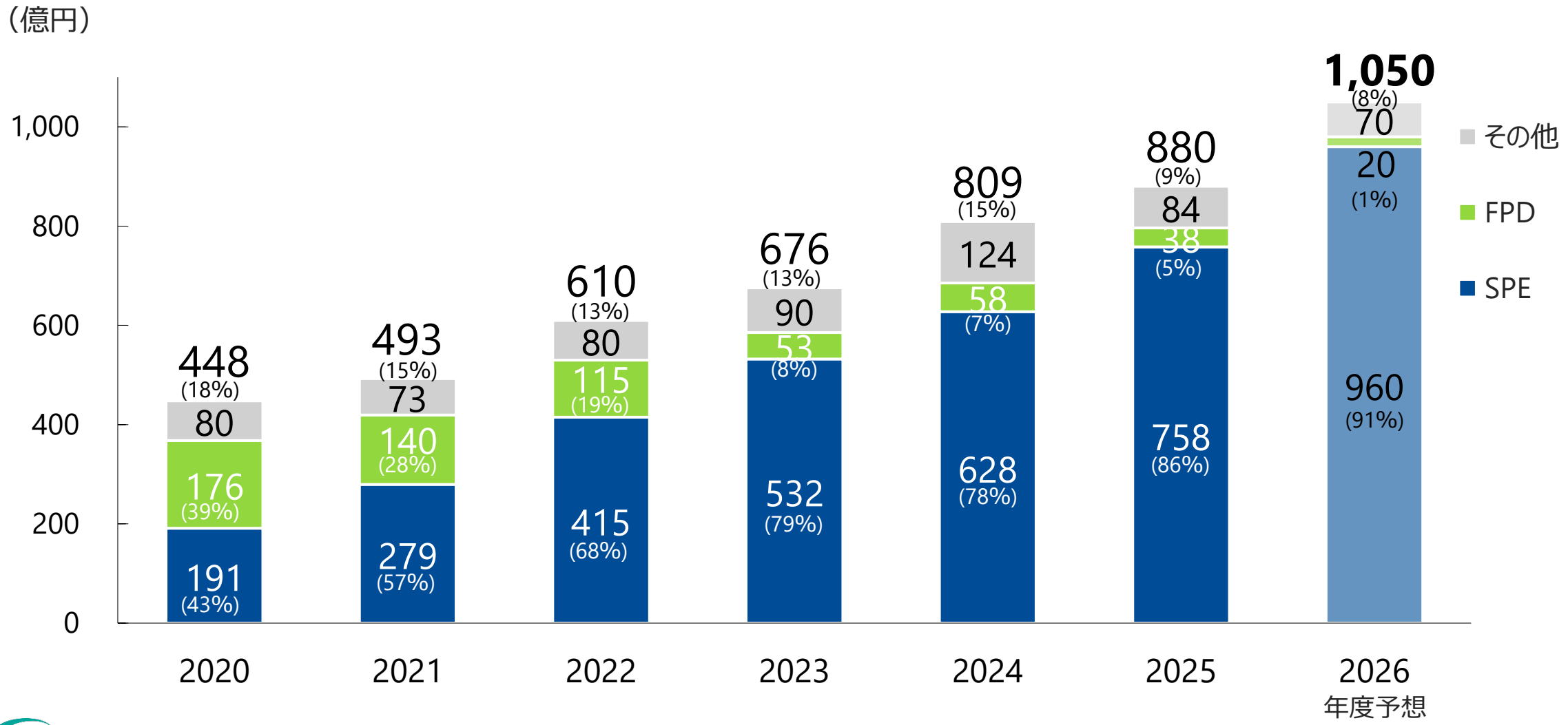
*海外関係会社の業績は従来ファインメカトロニクスセグメントに一括計上していましたが、26年度より各セグメント由来に区分し計上する方法に変更しています。
なお、当資料は23年度まで遡り、変更後の区分方法により作成しています。

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

分野別売上高予想

» SPE分野の売上拡大が全体を牽引、売上構成比は90%台

＊ SPE：半導体前･後工程
FPD：FPD前･後工程

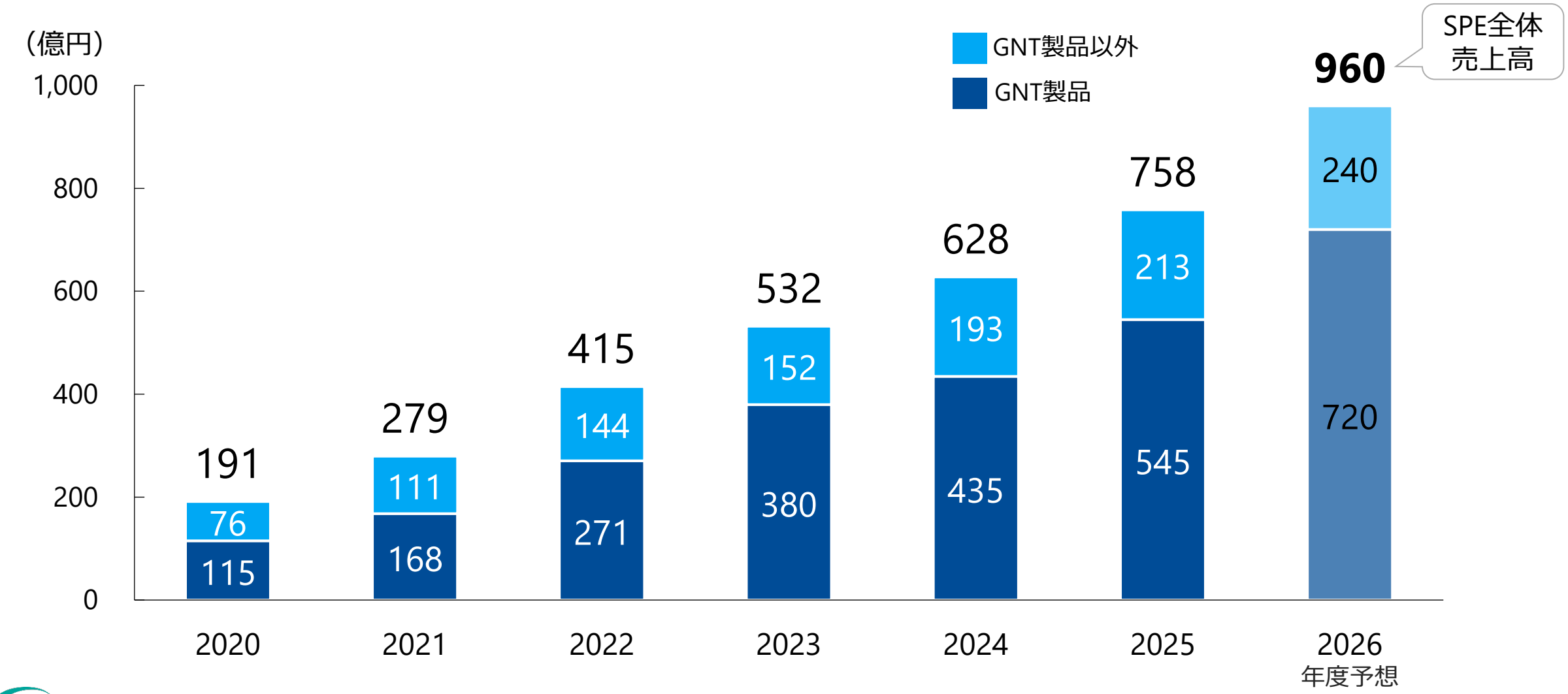


COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

SPE分野売上高予想

» GNT製品を中心に更なるSPE分野の売上規模拡大を見込む

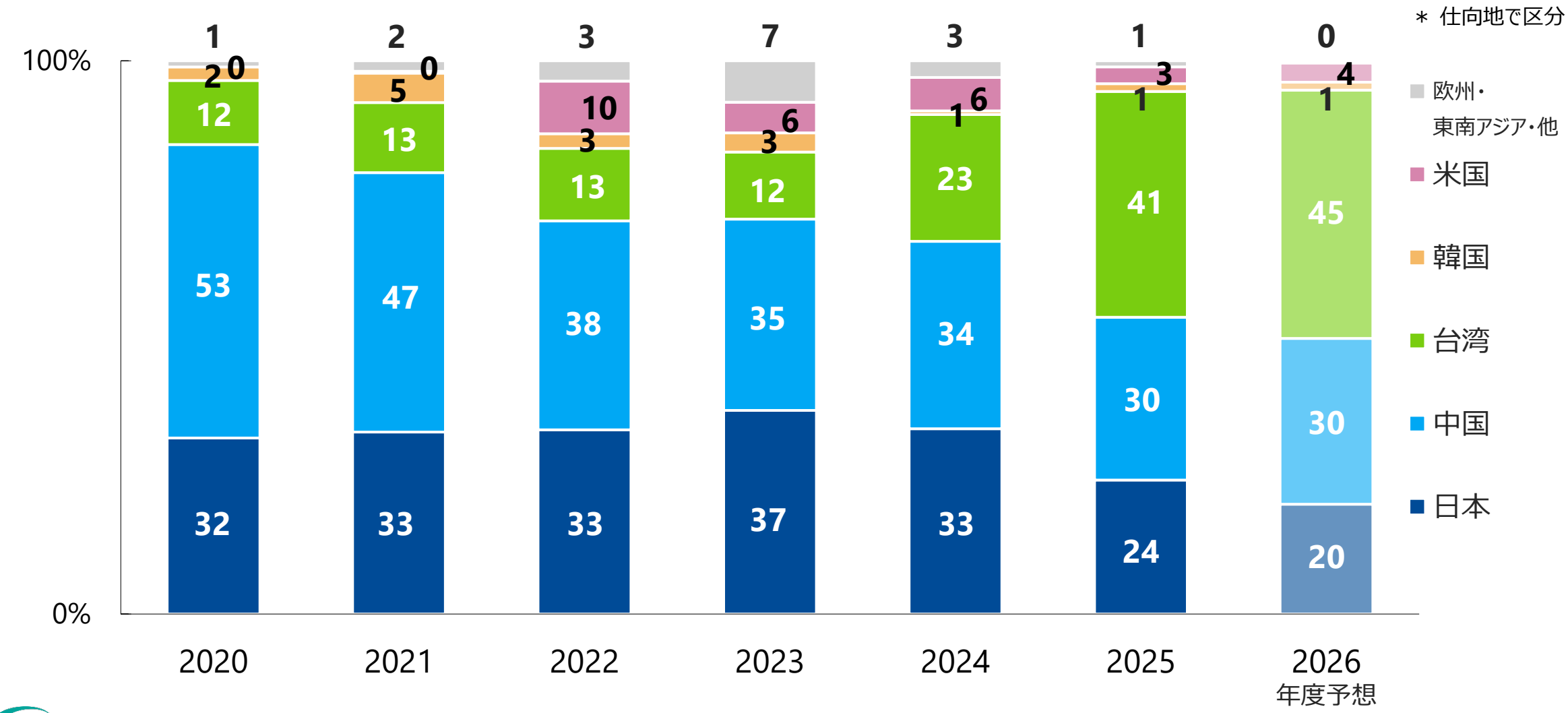
*GNT製品：当社グローバル ニッチトップ
対象製品群（cf. pp. 30-32）



COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

地域別売上高比率予想

» 海外向け80%（台湾45%、中国30%）



COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

03 中期経営計画の進捗

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

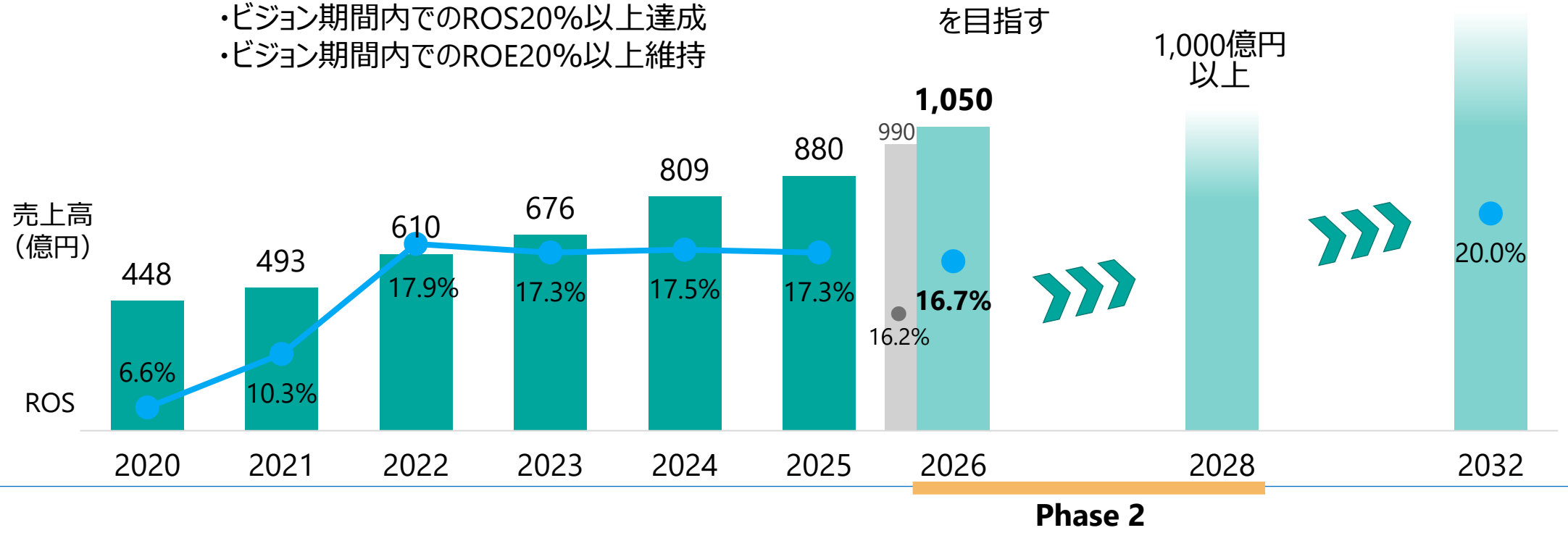
長期ビジョン「芝浦ビジョン2033」

» Phase 2期間内に前倒しでの連結売上高1,000億円以上達成を目指す→2026年度達成の見込み

10年後（2033年3月期時点）のありたい姿

社会やお客様の将来課題とそこにある潜在的ニーズを把捉して
能動的に提案・解決し、お客様と共に成長する企業

・**Phase 2期間内**での連結売上高1,000億円以上達成を目指す
・ビジョン期間内でのROS20%以上達成
・ビジョン期間内でのROE20%以上維持



COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

芝浦ビジョン2033　Phase 2（初年度予想）

» Phase 1（2023~2025年度）から引き続き好調に推移する見込み

（億円）	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度予想	対前年増減率
売上高	676	809	880	**1,050**	＋19%
営業利益	117	141	153	**175**	＋15%
ROS	17.3%	17.5%	17.3%	**16.7%**	-0.6pt
経常利益	116	140	149	**174**	＋17%
当期純利益	88	103	112	**125**	＋12%
ROE	24.5%	24.0%	21.7%	**21.2%**	-0.5pt
FCF	37	38	-35	**185**	＋220億円

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

芝浦ビジョン2033　Phase 2（基本方針）

芝浦ビジョン2033

	Phase 1：2023-2025 土台強化×市場ニーズ把捉	Phase 2：2026-2028 Phase 1 投資成果の刈取り×開発継続	Phase 3：2029-2032 お客様と共に成長
テーマ	「持続的成長に向けた投資」を柱として、次の成長に向けた土台強化を進め再び営業利益100億円超を目指す	・連結売上高1,000億円以上（‘26達成見込み） ・成長投資で利益率低下も、引き続きビジョン期間内でのROS20%以上、ROE20%（維持）を目指して取り組む	売上高の更なる成長と ROS20%以上達成 ROE20%以上維持 を目指す
中計の柱（基本方針）	①SPE分野の更なる拡大 ②持続的成長に向けた投資 ③課題とニーズの把捉 ④マテリアリティと連動したサステナビリティ経営推進	ポートフォリオ戦略 ①SPEプレーヤーとしての持続的成長 技術・事業開発戦略 ②投資成果活用と戦略開発投資の継続 製品・サービス一体経営（目指すビジネスモデル） ③課題とニーズに応える仕組み・ノウハウの実装・展開 経営の在り方 ④サステナビリティ経営の更なる推進	

売上規模拡大とともに
Phase2-3を通じて
製品・サービスの付加価値
向上や標準化等、利益率・
収益性改善策に取り組み、
ビジョン目標達成を目指す

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

SPE分野工程別　主要製品群

＊ いずれも環境調和型製品

＊ ■ 当社グローバル ニッチトップ対象製品群（GNT製品）が属す４工程（掲載機種は一例）

👉参照：製品・サービス

Siウェーハ製造



枚葉式Siウェーハ
洗浄装置

フォトマスク製造



フォトマスク
洗浄装置



フォトマスク
エッチング装置

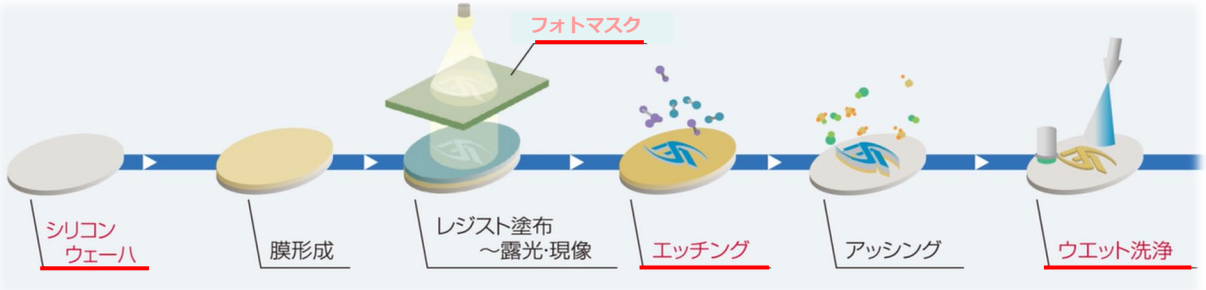
ボンディングプロセス

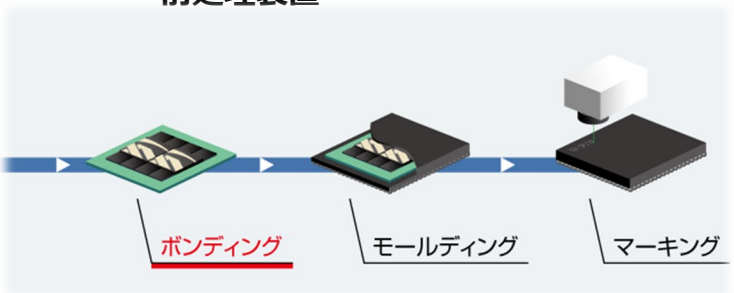


ハイブリッド接合
前処理装置



超高精度
ハイブリッドボンダ





ウェーハプロセス



高温リン酸エッチング装置

新しいGNT製品



（中工程向け）パネル用
ウェットスピン装置



FOSB／FOUP
洗浄装置

- 引き続き４工程の製品群をGNT製品群に位置付け
- GNT製品群を核としたSPE分野の拡大を追求
- 新しいGNT製品を創出



ハイエンド2.XD
パッケージボンダ



ハイエンドウェーハレベル
パッケージボンダ

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

前工程トピックス

ウェーハプロセス

ロジック／ファウンドリ
（CPU、GPU等）
メモリ（DRAM）

- 枚葉式高温リン酸エッチング装置は先端デバイス製造における量産適用に加え、レガシー製品の受注伸長、引続き顧客拡大、工程拡大に注力
- メモリー向け装置拡販に向け、評価を継続

👉参照：半導体製造装置　前工程



高温リン酸
エッチング装置

フォトマスク製造

ブランクス、PSM、
EUVマスク、
次世代EUVマスク

- 次世代EUV向け機種の展開に向けてフィールド検証継続
- レガシー向け機種のさらなるシェア向上を目指し、拡販への取り組み継続



フォトマスク
洗浄装置

Siウェーハ製造

Si、SiC、
各材料のウェーハ

- 更なる微小パーティクル低減に向けたウェーハ凍結洗浄プロセス開発を推進
- Siウェーハの需要急増を背景に、洗浄装置の設備投資拡大を見込む



枚葉式
Siウェーハ
洗浄装置

新しいGNT製品

半導体ウェーハ
出荷用FOSB、
ウェーハプロセス用FOUP

- デバイスメーカ、Siウェーハ製造メーカ向けFOSB／FOUP洗浄装置の顧客拡大に注力



FOSB／
FOUP洗浄装置

角型ワーク対応
半導体パッケージ
（2.5D、GPU、AIチップ）

- ウェーハからパネルへの移行が進み、量産に向けた初期設備投資が具体化



（中工程向け）パネル用
ウェットスピン装置

SHIBAURA

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

後工程トピックス

👉参照：半導体製造装置　後工程

ボンディングプロセス



ハイエンド2.XD パッケージボンダ
TFC-6500-W series
CPU、GPU

- 主力機種として多数の採用実績を獲得
- AI向け先端パッケージ需要を背景に受注が堅調に推移
- 次世代インターポーザに対応する新製品開発を推進



ハイエンドウェーハレベル パッケージボンダ
TFC-6600
CPU、GPU、アプリケーションプロセッサ

- 主力機種として受注が堅調に推移
- 多様なパッケージに対応する優れたオプション機能を拡充中
- AI関連市場の成長に伴う需要拡大を見込む



超高精度ハイブリッドボンダ
TFC-6800
ロジック、イメージセンサ

- 従来比3倍の高い生産性を実現
- ハイブリッドボンディング市場向けの中核製品



ハイブリッド接合前処理装置
HSM-1000
ロジック、イメージセンサ

- ハイブリッドボンディング向け前処理装置を販売開始
- TFC-6800との組み合わせによりワンストップソリューションを提供
- 顧客評価を進め、受注拡大を図る

SHIBAURA

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

新製品紹介（後工程）

Chip to Wafer（C2W）ハイブリッドボンディング及び フュージョンボンディングの接合前処理工程を一台で実現

👉参照：ハイブリッド接合前処理装置

■ニーズ

ハイブリッドボンディングでは、接合品質を確保するため、プラズマ活性化、洗浄、リンスなど複数の接合前処理工程が必要となる。そのため、これらの工程を集約した複合設備や、接合工程までをカバーするワンストップソリューションが求められている。

■用途

高性能サーバー、生成AI、高性能PCに使用されるロジック半導体、メモリデバイス向けの先端半導体パッケージ分野及びイメージセンサ分野

■特長

①ハイブリッドボンディングプロセスに求められる接合前処理プロセスを1台で実現

②各プロセスユニットの最適配置によりトップウェーハとボトムウェーハの WPH:≧10setsを達成（当社指定条件）

③ハイブリッドボンダとの組み合わせによるワンストップソリューションを提供

ハイブリッド接合前処理装置「HSM-1000」



COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

この先もずっと、
人と技術で
社会を支える。

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

芝浦メカトロニクスグループは、
「Smart」,「Solutions」,「Services」の3つの「S」で
お客様のものづくり、価値づくりに貢献し、
豊かな社会の実現を支えてまいります。



COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

見通しに関する注意事項

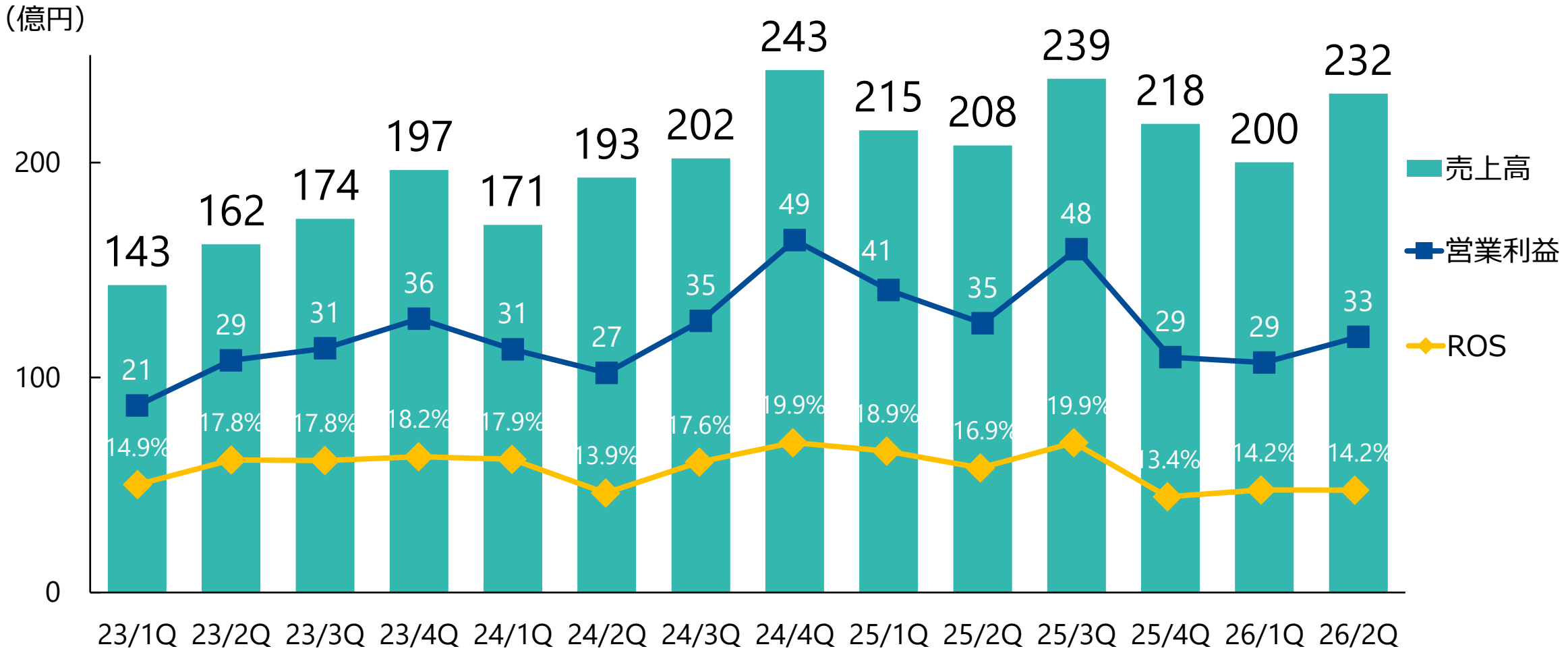
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Appendix

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

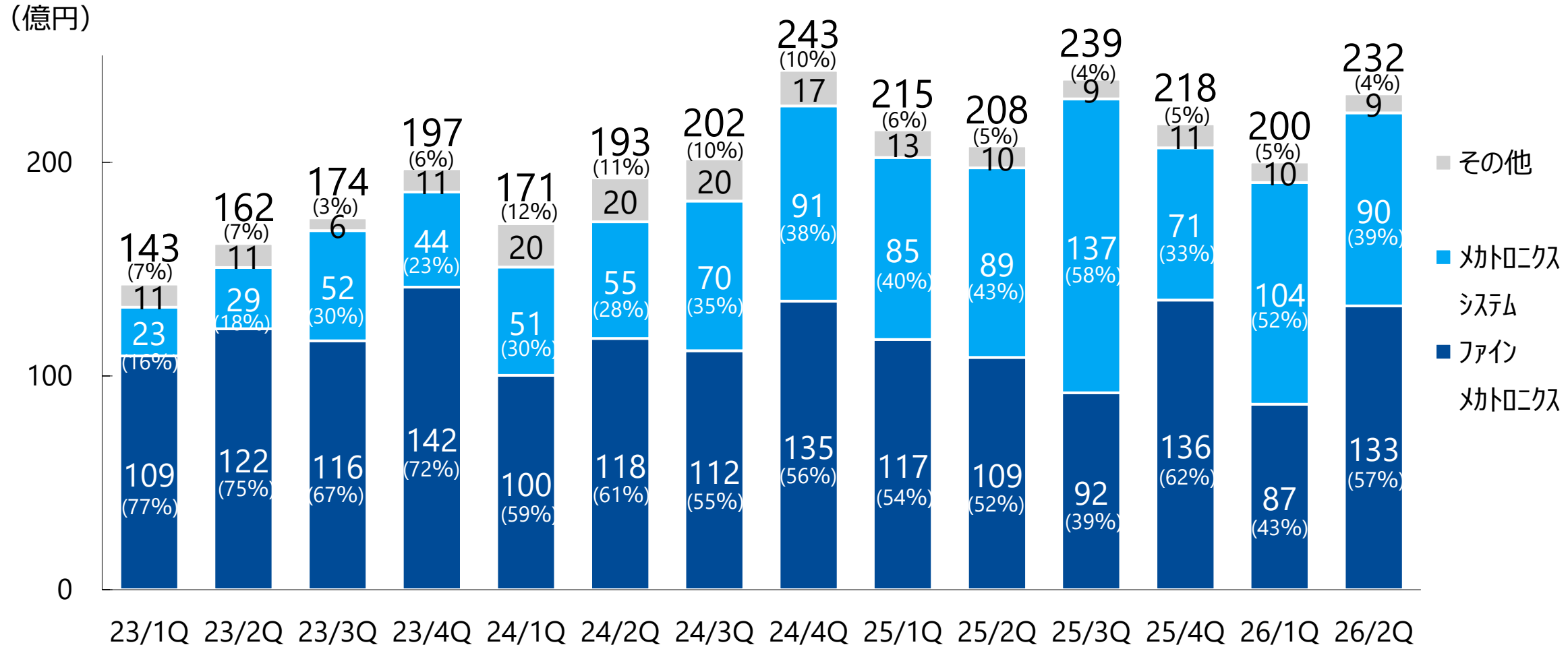
売上高・利益・ROS



COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

セグメント別売上高

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程、真空応用

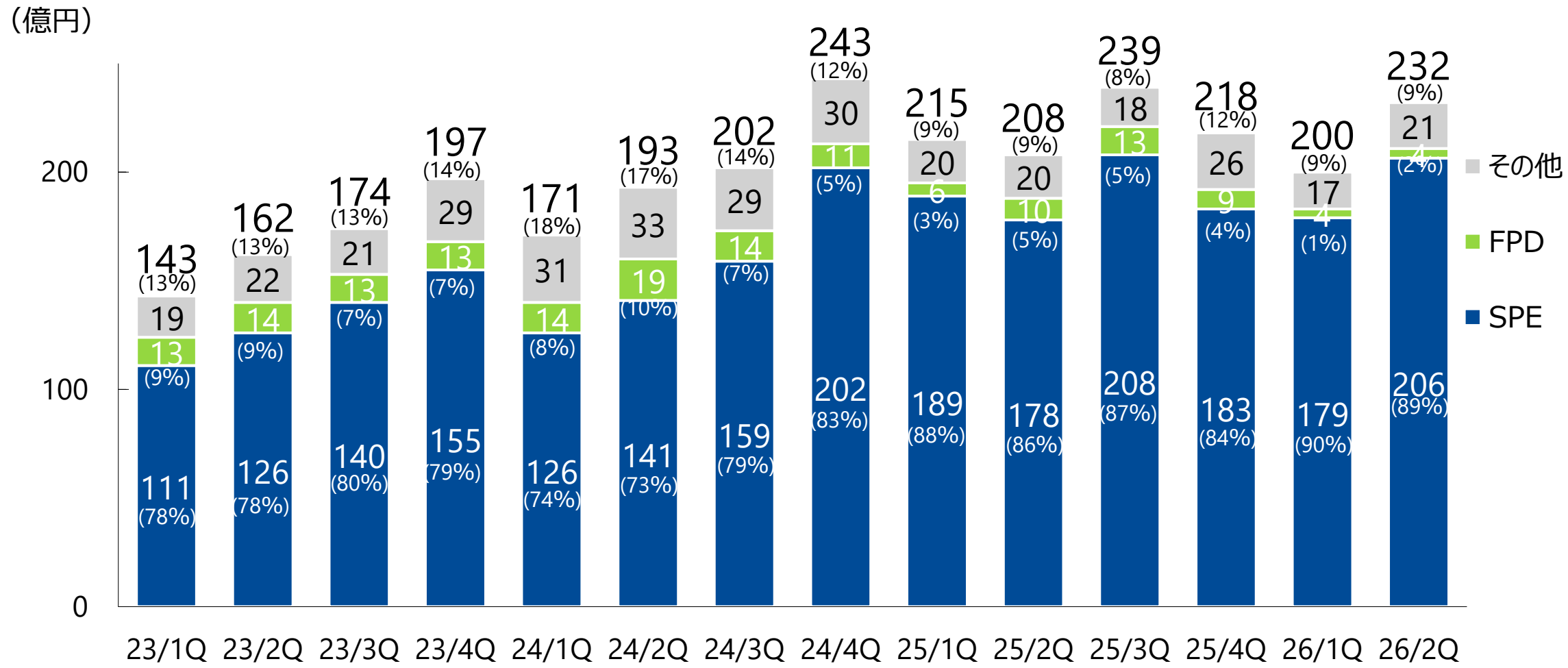


*海外関係会社の業績は従来ファインメカトロニクスセグメントに一括計上していましたが、26年度より各セグメント由来に区分し計上する方法に変更しています。
なお、当資料は23年度まで遡り、変更後の区分方法により作成しています。

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

分野別売上高

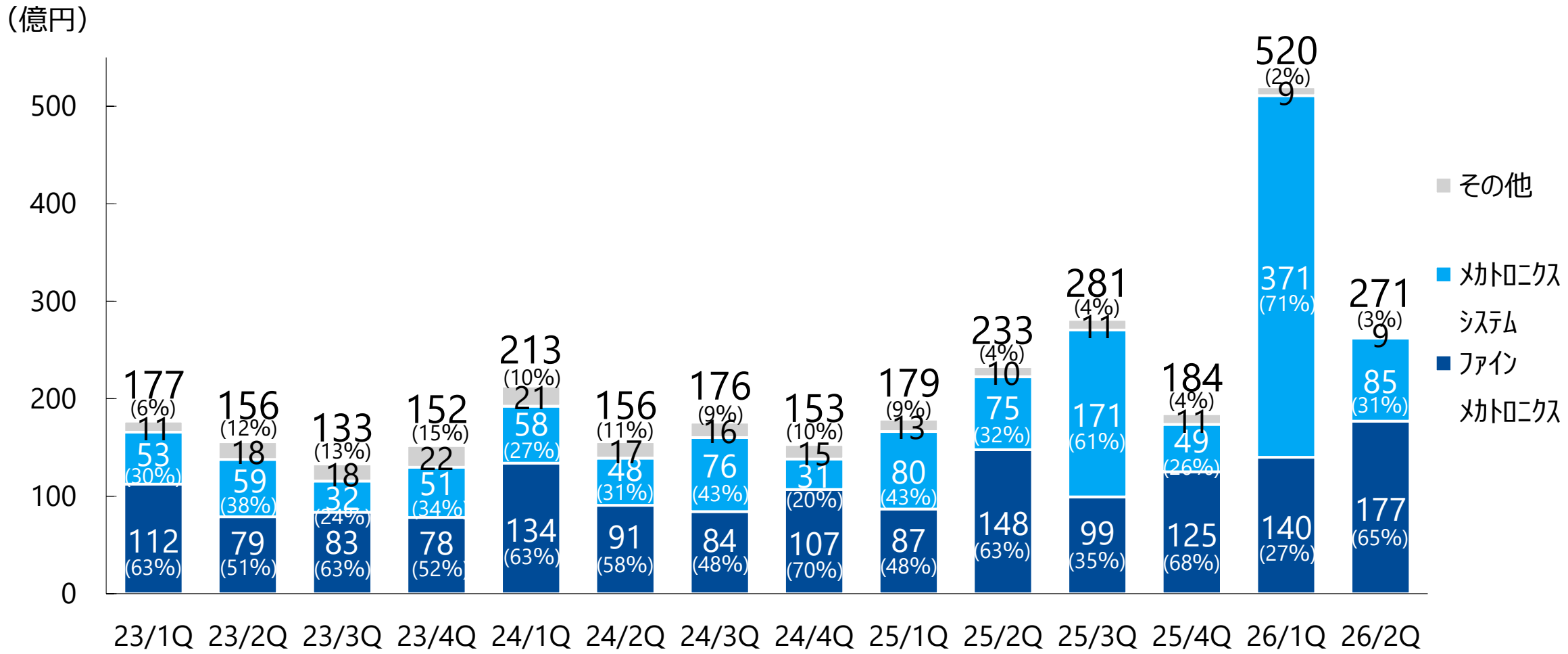
* SPE：半導体前･後工程
FPD：FPD前･後工程



COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

セグメント別受注高

＊ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程、真空応用

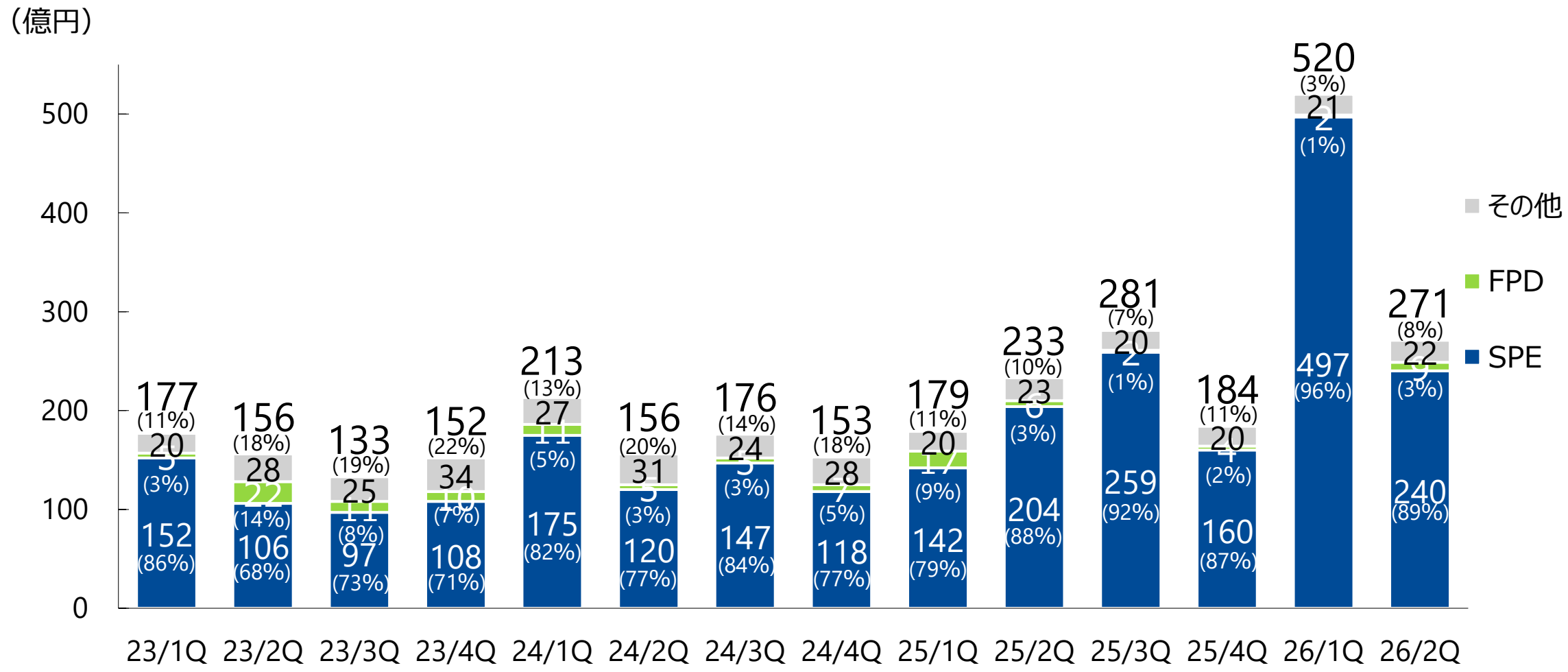


*海外関係会社の業績は従来ファインメカトロニクスセグメントに一括計上していましたが、26年度より各セグメント由来に区分し計上する方法に変更しています。
なお、当資料は23年度まで遡り、変更後の区分方法により作成しています。

COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

分野別受注高

* SPE：半導体前･後工程
FPD：FPD前･後工程



COPYRIGHT© SHIBAURA MECHATRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.